

有机硅导热填缝胶

GapSil 2600

序列号 TC 40

一、产品概述

GapSil 2600 (TC40) 是一种双组份有机硅导热填缝胶, 适用于电子电器产品的散热和减震防护。产品可以加热固化, 形成具有柔软的导热材料。

二、产品特性

- 导热率-4W/m.K, 比重-3.18;
- 固化过程中收缩小;
- 加热可快速固化;
- 绝缘性优异, 抗老化性能好, 可在-40~180℃内长期保持橡胶弹性;
- 符合 ROHS/REACH;

三、典型性能指标

序号	测试项目	单位	参考标准/条件	测试结果
1	A 组分外观	——	目测	白色膏体
2	B 组分外观	——		蓝色膏体
3	A 组分粘度 ¹	Pa s	GB/T 10247	261
4	B 组分粘度 ¹	Pa s		167
5	A、B 混合比例	——	——	1:1
6	混合后开放时间	min	——	60
7	固化时间 ²	h	25℃	<24
8	密度	g/cm ³	HG/T 2728	3.18
9	邵氏硬度 ³	Shore 00	GB/T 531.1	55
10	导热系数	W/(m K)	ISO 22007-2	4
11	体积电阻率	Ω·cm	GB/T 1692	>1×10 ¹⁴
12	击穿电压强度	kV/mm	GB/T 1695	>6
13	阻燃等级	——	UL94	V0

注: 1、采用设备型号: Anton Paar Rheometer, 测试剪切速率为 10s⁻¹;

2、操作时间和初固时间: 根据客户实际要求调整;

3、固化条件为 150℃1h;

四、应用领域

广泛应用于精密电子元器件、电子模块、电池模组, 电器模块、照明电器、光伏逆变器、电源和线路板等的散热和减震保护。

五、施工方法

有机硅导热填缝胶

GapSil 2600

序列号 TC 40

1、将 A、B 两组分按质量比或者体积比 1: 1 计量, 然后通过静态混合器混合均匀, 以手动或者自动点胶到应用界面上, 然后加热固化条即可;

2、温度偏低会导致固化速度偏慢。

六、使用注意事项

1、将 A 和 B 两组分混合时, 配比不准确将会影响硫化过程和制品性能, 因此要准确控制比例。

2、如果胶料接触某些如含氮、磷、硫、锡等化合物的物质, 则会抑制硫化反应, 严重将导致产品不硫化, 应极力避免和此类物质接触。

七、包装规格

- A/B 支装: 200/200 毫升

- A/B 桶装: 5 加仑或者/55 加仑

八、储存及运输

1、需避光、避热、密封储存 (可作为非危险品运输及储存);

2、低于 40°C 条件下可储存 6 个月。

九、有限保证信息

此处提供的信息与我们的实践经验一致。然而, 由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制, 本信息不能取代客户为安全、有效并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的建议, 不得被视为侵犯任何专利权的导因。本产品资料不能被视为完整的资料, 本公司对此不承担任何义务, 同时也不对第三方提出的索赔要求负任何义务。